



SCIENTECH

辛耘

許明棋 2025/12/16

- 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。



公司簡介

基本資料 | 公司歷程 | 全球據點 | 組織架構





產品與服務

- 設備研發製造-Equipment Design and Manufacturing
- 晶圓再生-Wafer Reclaim
- 代理事業-Representative



我們服務的產業

- 半導體 (前段/先進封裝)-Semiconductor (Front-End and Advanced Packaging)
- 化合物半導體-Compound Semiconductor
- LED / Mini LED / Micro LED
- 平面顯示器-Flat Panel Display (TFT-LCD, AMOLED, Touch Panel)



設立年度:
1979
Taipei, Taiwan

實收股本:
US\$ 27 Million
TWSE:3583

員工人數:
>1,150 (全球)

員工人數

[ABOUT US](#) [PRODUCTS](#) [CONTACT US](#)



超過 1,150 員工

代理事業

- 台灣:140
- 大陸:130
- 70%具設備製程與工程經驗

設備研發與製造

- 475 員工
- 166以上同仁具有研發設計與製程與工程經驗

再生晶圓

- 320 員工

管理部

- 85 員工

公司歷程

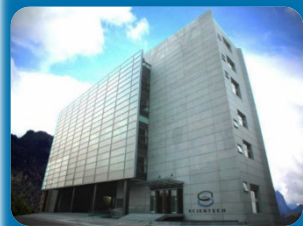
ABOUT US PRODUCTS CONTACT US



SCIENTECH

1979

設立於台北



1985

新竹辦公室, Taiwan

1995

美國子公司(加州)

2001

大陸子公司(上海)

2002

新加坡代理商

2003

自製機台研發與製造

2021

歐洲子公司(奧地利)

2019

自製設備500台出貨

2013

辛耘在台灣交易所上市掛牌

2007

湖口廠辦大樓落成

2006

再生晶圓事業

2004

新竹辦公大樓

台北總公司

新竹辦公大樓

湖口廠辦大樓

- 設備研發製造
 - ◆ 配備10級/1000級/10000級無塵室
- 再生晶圓



台中辦公室

高雄辦公室

台南辦公室

歐洲子公司

Villach, Austria (2020)

- 負責提供歐洲客戶一條龍銷售與客服
- 本公司及歐洲客戶對接窗口
- 新產品/產品開發

美國子公司

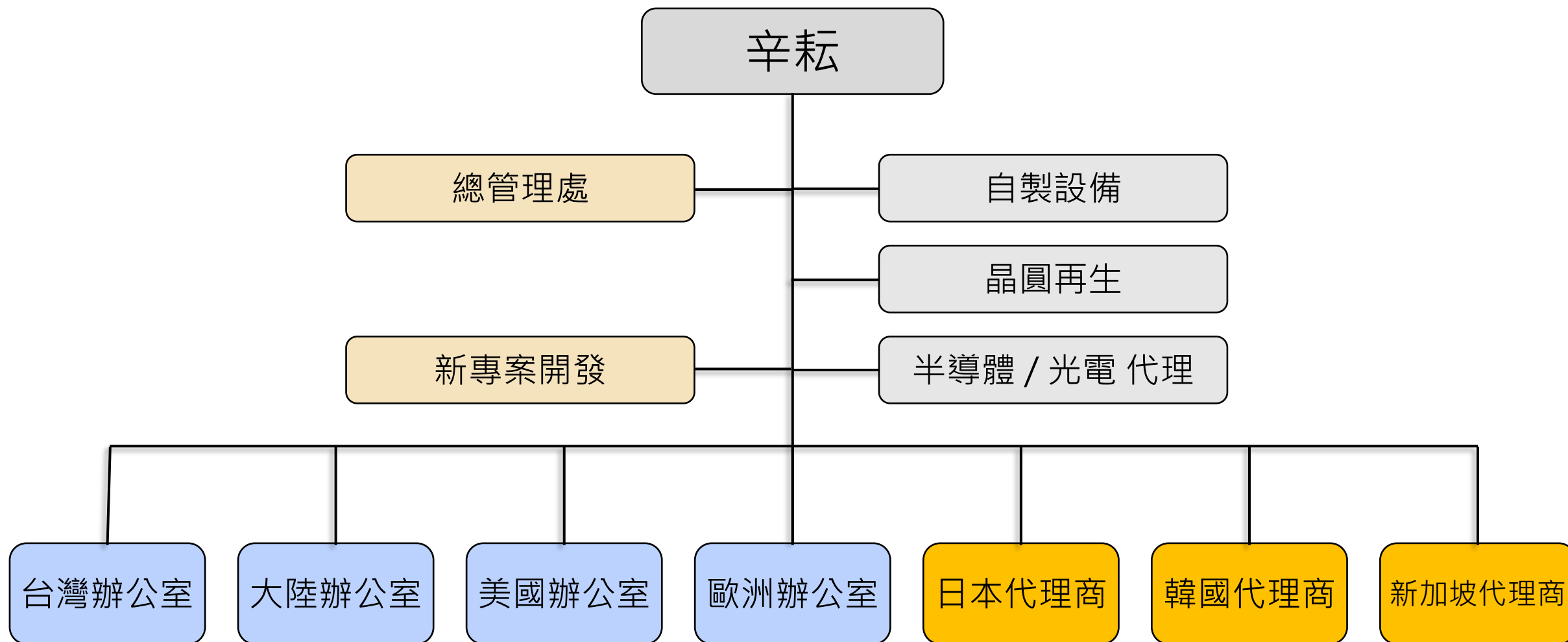
Santa Clara, CA (1994)

- 負責銷售與客服服務
- 負責原廠與美國客戶對接服務
- 新產品/產品開發

大陸子公司

- 北京辦事處 (2004年)
- 大連辦事處 (2012年)
- 西安辦事處 (2013年)
- 重慶辦事處 (2010年)
- 常州辦事處 (2012年)
- 無錫辦事處 (2003年)
- 上海辦事處 (2001年)
- 蕪湖辦事處 (2013年)
- 廈門辦事處 (2011年)
- 惠州辦事處 (2013年)
- 昆明辦事處 (2002年)

辛耘公司組織架構



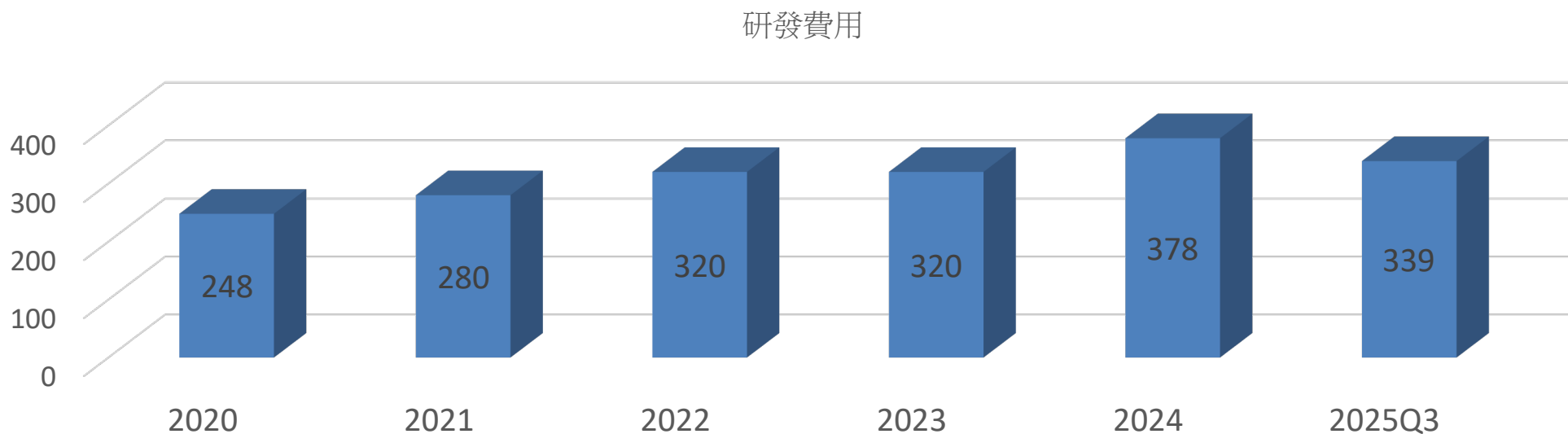
產品與服務

設備研發與製造 | 再生晶圓 | 代理事業



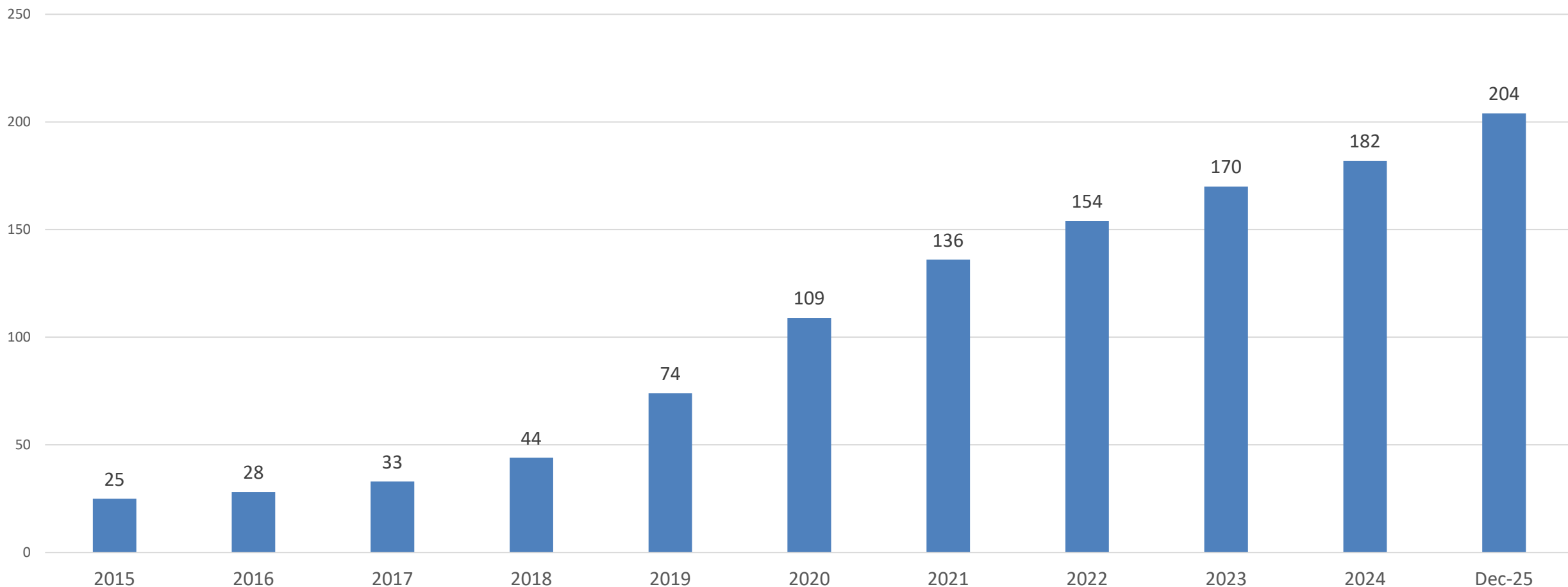
研發費用

單位：百萬	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q3
研發費用	248	280	320	341	378	339
研發費用佔 營業收入比重	6.9%	6.0%	5.7%	4.9%	3.9%	4.0%
研發費用佔 製造比重	16.5%	14.9%	15.3%	15.7%	11.3%	9.9%



研發專利累積數

- 在案專利累積數**204**件；申請中**50**件





設備研發與製造

- 新進封裝-Advanced Package
- 半導體前段製程-FEOL
- 光罩-Mask
- 化合物-Compound
- 其他



再生晶圓

- 12" Si Wafer



代理事業

- 設備/量測設備
- 子系統-Sub-System
- 材料-Material
- 維修和翻新-Repair and Refurbish

先進的清潔技術

- **19nm Particle**
- **Low Trace Metal (<1E9)**

進階缺陷檢測

- **Inspection (SP1/SP2/SP5/SP7)**



12" 矽晶圓

- 產能: 210K / 月



產能擴充計畫

- 2026年底再增加月產能 40K

完整的拋光製程

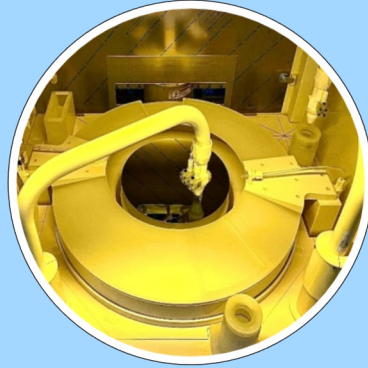
- **Single/Double Side Polish**
- **Final Haze Polish**

超級平整度

(GBIR < 0.5mm)



批次式濕式製程



單晶圓濕式製程



暫時性貼合及剝



烘烤設備

批次式濕式製程設備

應用產業

- Semiconductor: FEOL, BEOL, Compound
- Advanced Packaging/Bumping...

製程應用

- Etch: Metal/Oxide/Nitride remove
- Stripper: PR/PI strip, Polymer remove
- Clean: Pre/Post/Flux clean
- Electro-less Plating: Zn/Ni/Pd/Au

功能特色

- Cassette type or Cassette-less type
- Adopted by big international companies
- Leading-edge technologies



單晶圓濕式製程設備

應用產業

- Semiconductor: BEOL, FEOL, Compound
- Advanced Packaging/Bumping

製程應用

- UBM / Metal Etch
- Flux Clean (Hot DIW)
- PR Strip
- Wafer Clean (APC, Soft spray)
- Final Clean/Mask Clean/Frame Clean

功能特色

- Soak/Immersion + Single
- Adopted by big international companies
- Leading-edge technologies



暫時性貼合及剝離設備(TBDB)

應用產業

- IGBT & SiC Power Device
- Advanced Packaging for Semiconductor

功能特色

- User-friendly graphical user interface
- Adopted by big international companies
- Leading-edge technologies

製程應用

- Temporary Bonding
- Temporary De-bonding
- Release Layer Coating
- Carrier (Glass) Recycling



水氣烘烤設備

應用產業

- Semiconductor: BEOL
- Advanced Packaging for Semiconductor

製程應用

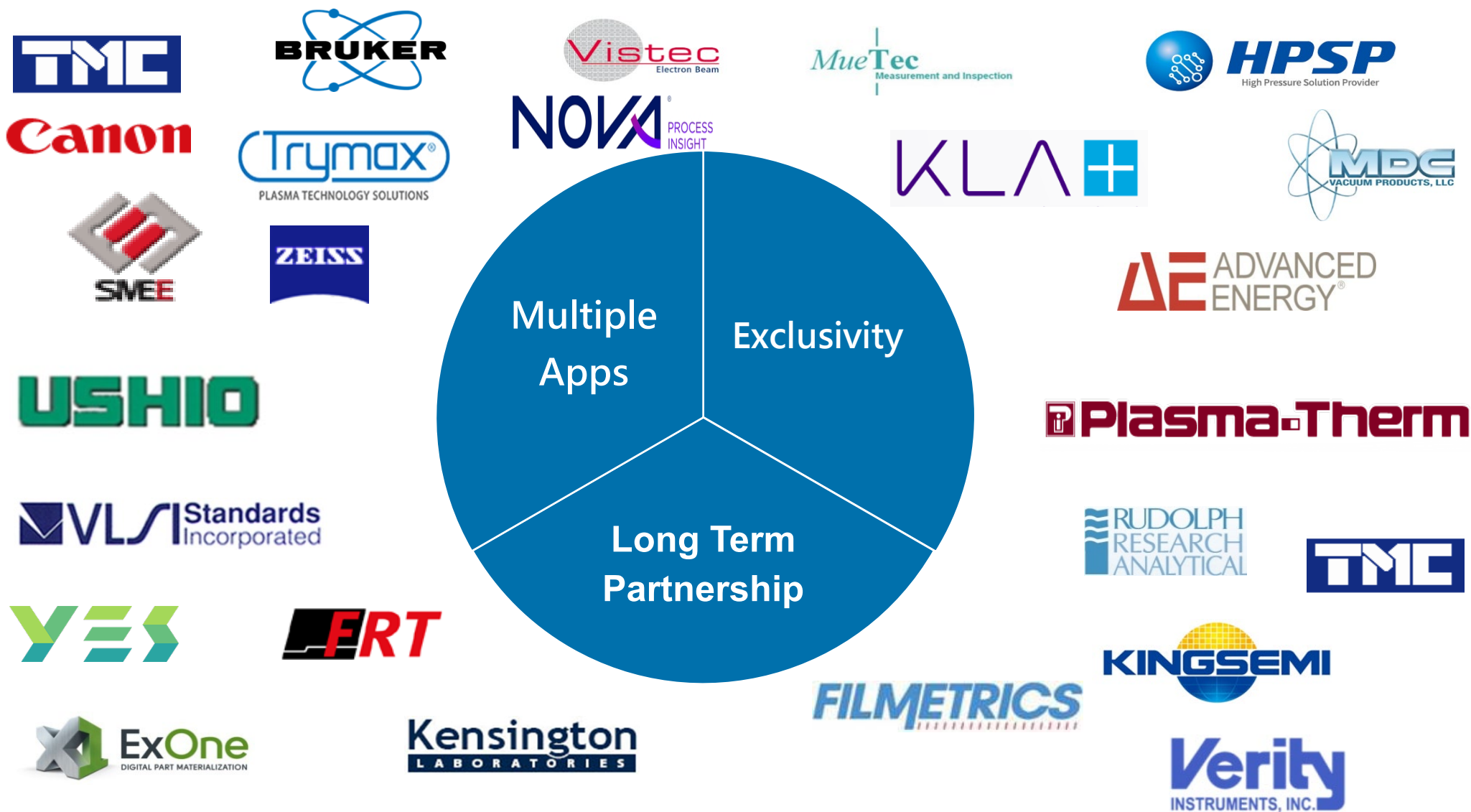
- Pre-underfill baking
- Pre-mold baking
- DFR Hard Bake

功能特色

- Availability for horizontal or vertical process
- High precision temperature control
- Weight handling capacity up to 23kg per lot



代理事業

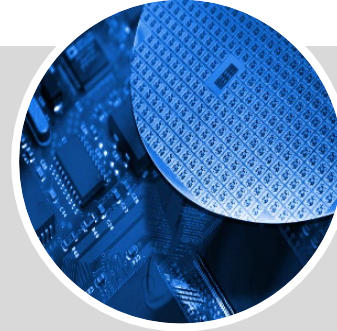




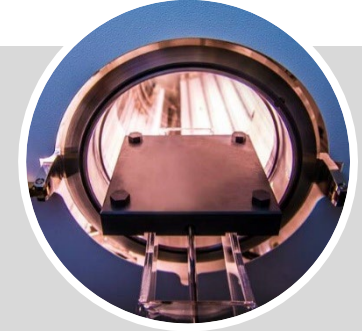
Lithography



Etch



Thin Film



Diffusion





Metrology



Sub-Systems



Package & Material



Robot Repair and Refurbish



公司治理





發行永續報告書



E



環境友善

S



溫馨職場



回饋社會

G



誠信經營



SEMICON®

Semicon China

Mar. 26-28, 2025
Shanghai



SEMICON®

Semicon TW

Sep. 10-12, 2025
Taipei



SEMICON®

Semicon West

Oct. 07-09, 2025
Phoenix



SEMICON®

Semicon Europa

Nov. 18-21, 2025
Munich



ISES

May 13-14, 2025
Taipei



ECTC

May 27-30, 2025
Dallas, Texas

營運概況

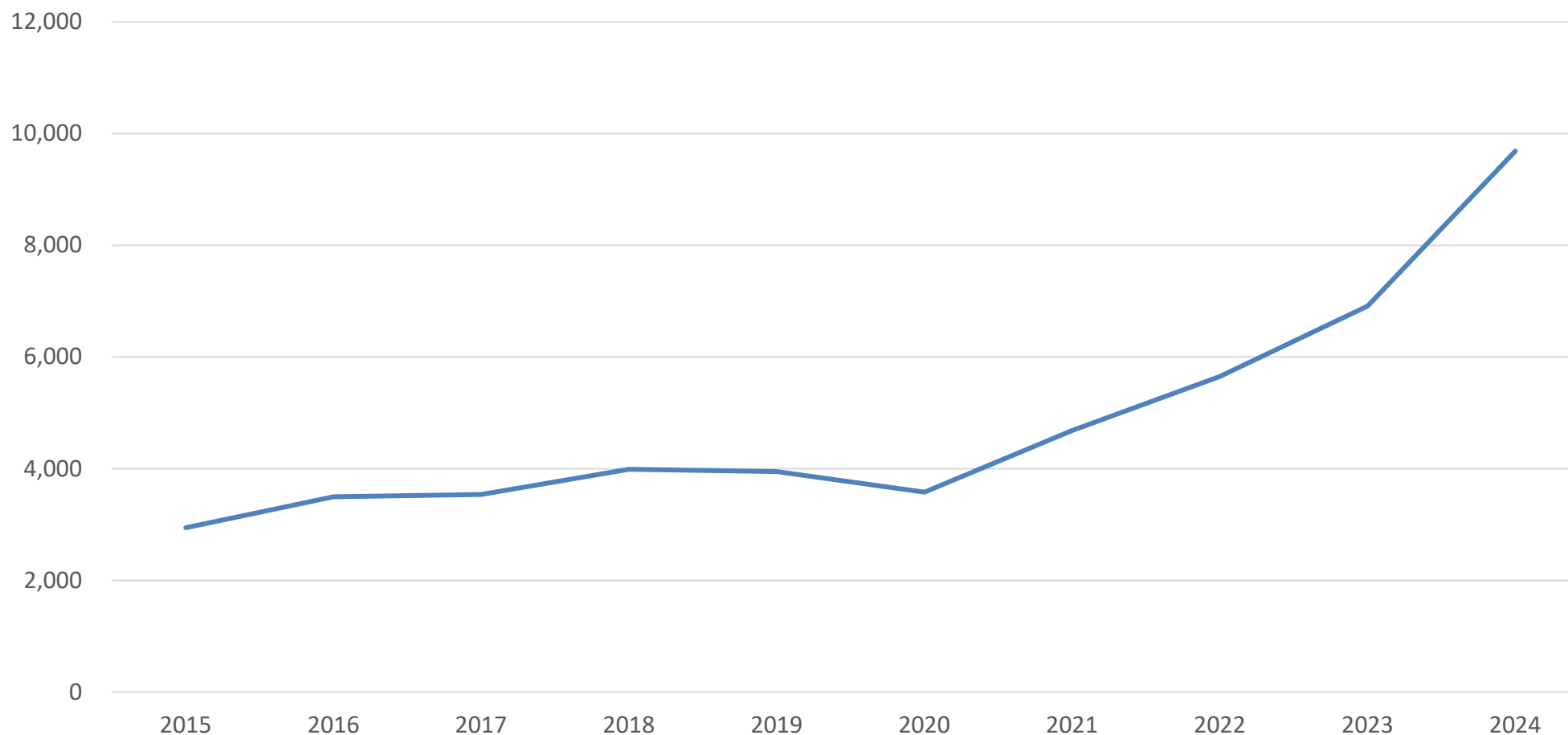


簡明損益表

單位：新台幣百萬	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q3
營業收入	3,580	4,684	5,650	6,911	9,688	8,557
營業毛利	1,456	1,667	2,084	2,201	2,906	2,768
營業費用	991	1,112	1,374	1,483	1,790	1,619
營業淨利	465	555	710	718	1,116	1,149
稅前淨利	389	524	736	860	1,277	1,073
歸屬母公司淨利	305	420	568	650	927	780
EPS(新台幣元/股)	<u>3.80</u>	<u>5.23</u>	<u>7.08</u>	<u>8.10</u>	<u>11.54</u>	<u>9.71</u>
毛利率	41%	36%	37%	32%	30%	32%
營業淨利率	13%	12%	13%	10%	12%	13%
稅前淨利率	11%	11%	13%	12%	13%	13%

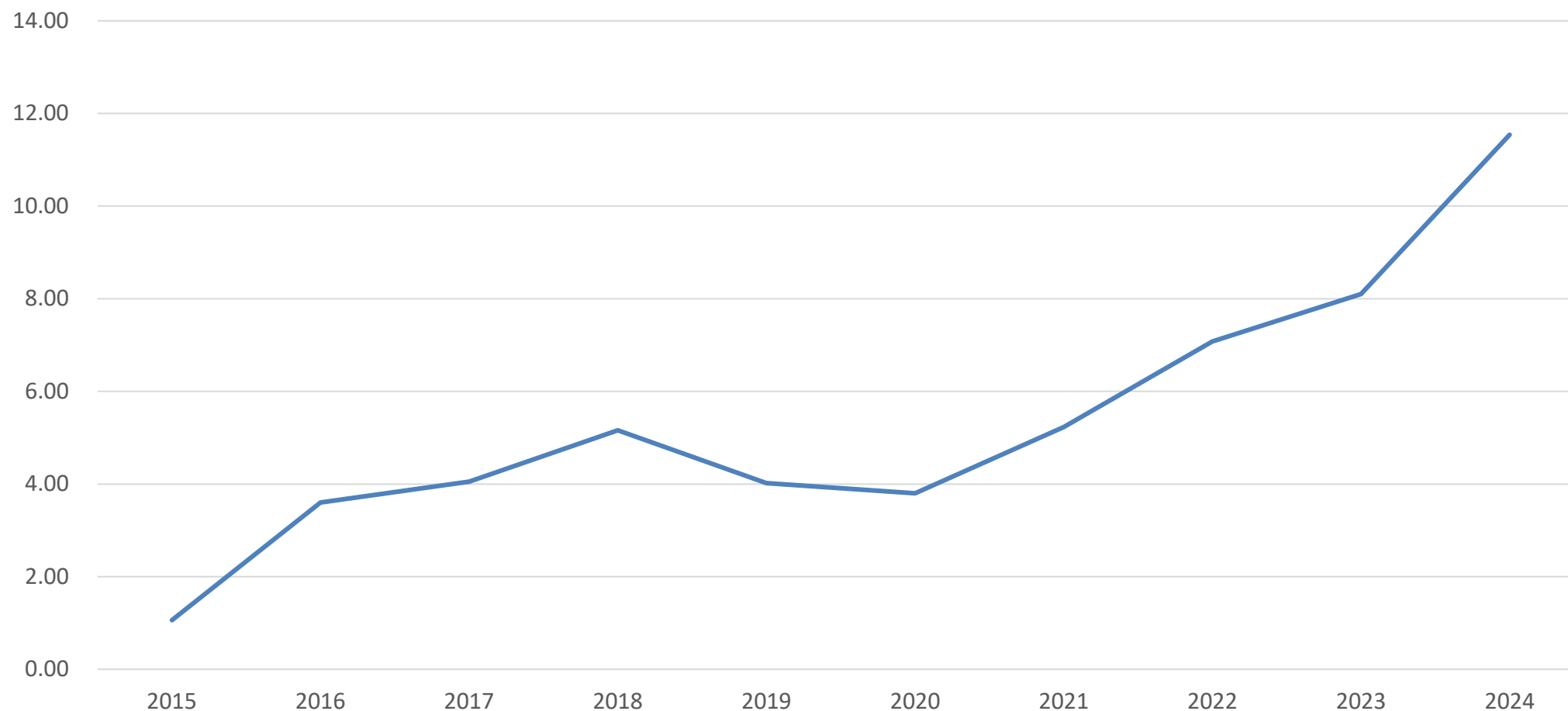
歷年營收

單位： 新台幣百萬	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q3
營業收入	2,942	3,495	3,539	3,988	3,949	3,580	4,684	5,650	6,911	9,688	8,557



歷年 EPS

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q3
EPS	1.06	3.6	4.05	5.16	4.02	3.8	5.23	7.08	8.1	11.54	9.71



未來展望



- 未來10年半導體市場年複合成長率約為8%。
- 預期2025年，全球半導體市場成長率11%。
- 受人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用需求的驅動，台灣半導體市場預估如下：

年度	市場規模 (美金10億元)	成長率(%)
2025	181	15.4
2026	???	???

- 12吋半導體先進製程持續蓬勃發展。
 - Front-End: 5nm、3nm、2nm、1nm
 - Advanced Package: Fan-Out、2.5D (CoWoS)、3D (SoIC)...etc

- 預計未來 10 年先進封裝產業的年複合成長率將達到 11%。
- 為滿足人工智慧晶片應用增長的需求，CoWoS的產能大幅擴張。
- 人工智慧應用正從資料中心擴展到邊緣運算和個人設備。
- 中國的半導體產能正在擴大，成熟製程節點的價格競爭日益激烈。
- 化合物半導體Compound Semi:
 - 對電動車和5G的投資停滯不前。
 - 手機需求趨於飽和，導致砷化鎵產量下降。
 - 伴隨SiC新增產能成長放緩，SiC需求逐步成長。
 - Micro LED 的普及應用進展緩慢。

- 2023:湖口新建裝備生產基地(異地)。
- 2024:湖口工廠現有設備生產擴建。
- **2025 Q4:**湖口工廠再生晶圓產能再增加5萬片/月。
- **2026 Q4:** 9,000平方公尺的新廠房（二廠）用於設備製造與倉庫，毗鄰湖口廠（一廠）。
- **2026 Q4:**湖口工廠再生晶圓產能再增加4萬片/月。
- **2027 Q2:**台南新建一座佔地 22,000 平方米的設備製造和倉儲大樓。
- 2027:湖口工廠再生晶圓產能再增加5萬片/月。



SCIENTECH

Thank You!

<https://www.scientech.com.tw>